



TESEC

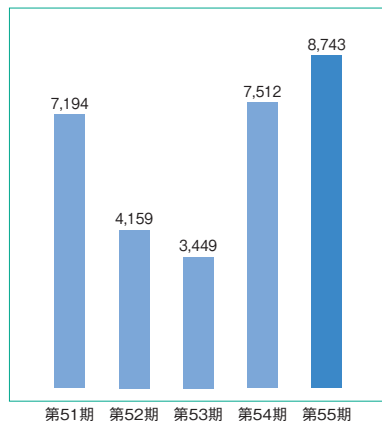
第55期 事業レポート

2022年4月1日～2023年3月31日

決算ハイライト (連結)

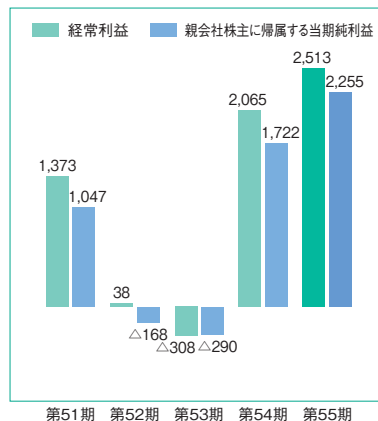
売上高

(単位：百万円)



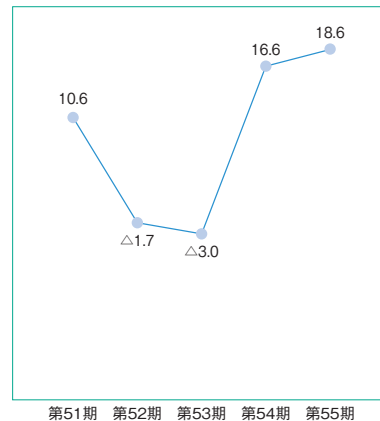
経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



自己資本利益率 (ROE)

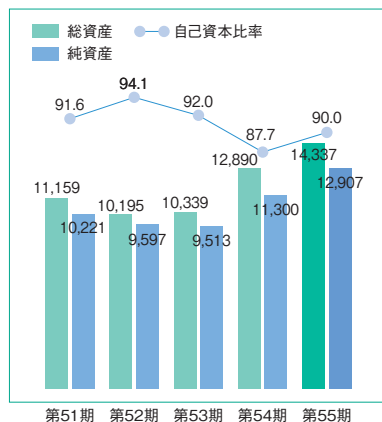
(単位：%)



総資産・純資産 自己資本比率

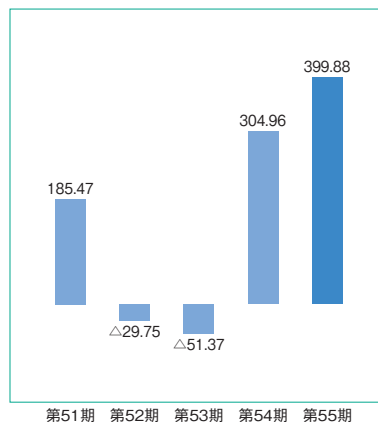
(単位：百万円)

(単位：%)



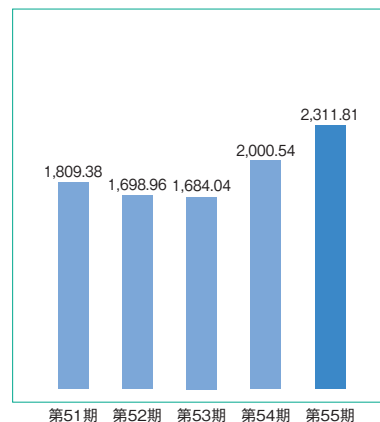
1株当たり当期純利益

(単位：円)



1株当たり純資産額

(単位：円)



トップメッセージ

平素は当社の事業運営に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに第55期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の事業の概況についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の行動制限が緩和される一方、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化によりエネルギーや原材料価格の高騰、物流の混乱に拍車がかかりました。インフレ鎮静化に向け、米国ではハイペースの利上げが進み、欧州も金融引き締めに動くなか、一部銀行の破綻により信用不安が表面化しました。中国ではゼロコロナ政策が解除され経済活動が正常化に向かいましたが、金融緩和の続く日本では数十年ぶりの水準となった円安が輸入物価を押し上げるなど、景気後退への懸念が高まりました。

半導体業界におきましては、中国経済の失速などからパソコンやスマートフォン向け需要が落ち込みましたが、車載向けなどで需要が増加しているパワーデバイスは堅調に推移しました。全体として半導体市場は悪化したものの、米国による対半導体輸出規制等、戦略物資としての半導体のサプライチェーンのあり方が各国で意識されるなか、半導体メーカーの中長期的な投資意欲は継続しました。

このような状況のなか、顧客ニーズに応える製品の開発や投入に注力するとともに、パワーデバイス用テストやMAPハンドラ、自重ハンドラなどを軸として、顧客基盤拡大に向けた受注活動を展開しました。生産面では、電子部品を中心とした調達難が解消せず、一部出荷計画の遅延や納期要因による失注が発生したこと、部材等の先行発注を増やすとともに、代替品利用のための設計変更や複数社購買を進めました。

以上の結果、受注高は85億85百万円（前期比20.6%減）、売上高は87億43百万円（同16.4%増）、期末受注残高は60億42百万円となりました。製品別売上高はハンドラ46億60百万円（同17.1%増）、テスト26億20百万円（同23.4%増）、パーツ等14億62百万円（同3.8%増）となりました。

損益面は、原材料価格の高騰に伴う影響があったものの、為替が円安に動いたことから利益率が上昇し、営業利益は21億33百万円（同22.0%増）、外貨建て資産の評価に係る為替差益の計上により、経常利益は25億13百万円（同21.7%増）となりました。また、繰延税金資産および法人税等調整額の計



代表取締役社長 田中 賢治

上により、親会社株主に帰属する当期純利益は22億55百万円（同30.9%増）と、22年ぶりに最高益を更新しました。

世界の半導体業界は、データセンターの増強、自動車の電動化などのデジタル化、カーボンニュートラルへの取り組みが世界的なトレンドとなるなか、半導体製造装置市場は短期的には変動しつつも、中長期的には堅調な推移が予想されます。2023年の半導体市場は4年ぶりのマイナス成長が予想されていますが、足下では車載用パワー半導体向け装置の引合は堅調に推移しており、高水準の受注残高を抱えています。

一方、当社の内部環境に目を向けますと、従業員の高齢化と人員の減少が進んでいます。デジタルによる業務効率改善を進めることは当然として、中長期目線での人財戦略が必須となっています。このような状況において、ソリューションを提供する創造業のトップランナーとなり、優れた半導体検査装置を世界中に供給することで快適で安全な低炭素社会に貢献するというミッションを着実に果たすべく、当社は2022年度を初年度とする3ヵ年の新たな中期経営計画「Enjoy2.0」を策定し、運用しております。

中期経営計画で掲げた基盤戦略、事業戦略、財務戦略の実現に向けて、前進しておりますが、更なる全社的な業務効率化、情報の共有化、人材の有効活用を推進してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きより一層のご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

車載関連を中心にパワーデバイス向け製品が好調に推移し、増収増益を実現。 受注は好調な一方、今期も部品不足が大きな事業リスクに。

当期（2023年3月期）は、半導体市場全体が停滞気味にあるなか、当社が主なターゲットとしているパワーデバイスは、電気自動車を中心に比較的好調に推移しました。その一方、サプライチェーンの混乱によって、部品不足が引き続き問題となっています。このようななか、テセックはどのように事業を進めてきたのか、また、今後どのように取り組んでいくのか、田中社長に伺いました。

Q 当期（2023年3月期）の事業環境および業績の概況をお聞かせください。

A 当期は、世界的にもコロナ禍による行動制限が緩和される一方、ロシアのウクライナ侵攻の長期化によりエネルギーや原材料価格の高騰、サプライチェーンの混乱に拍車がかかりました。半導体業界は、中国経済の失速などによってパソコンやスマートフォン向けの需要が停滞する一方、車載向けは堅調に推移しました。前工程やメモリ関連は落ち込みがあったものの、我々の後工程、パワー系は安定的な成長が続きました。

こうした状況下、当社は、パワーデバイス用テストやMAPハンドラを軸に、顧客ニーズに対応した製品を投入し、顧客基盤拡大に向けた受注活動を積極的に展開しました。しかし、生産面においては、前期に引き続き電子部品の調達難が解消せず、出荷計画の遅延や納期要因による失注が発生しました。

これらの結果、受注高は21%減少したものの、売上高は16%の増収となりました。利益面では、原材料価格の高騰が響いた反面、売上拡大および円安進行による為替差益の計上などにより、すべての利益項目で増益となりました。また、純利益については、繰延税金資産および法人税等調整額の計上も寄与し、22年ぶりに最高益を更新しました。

Q 部品不足の影響とその対応についてお聞かせください。

A 2年ほど前にも部品不足に悩まされましたが、当時は特にハンドラに使われるメカニカル部品の入荷が滞りました。今回はテスト用の部品調達において電子部品の不足が鮮明となり、1年以上を経過した現在も解消には至っていません。テストを構成する部品は非常に多く、9月の時点では約600点の部品が通常ルートで入らない状況でした。その後徐々に緩和に向かい現在は100点ほどになりましたが、厳しい状態にあることは変わりません。

部品不足への対策として、メーカー、商社への問い合わせ対応はもちろん、開発、生産、海外現地法人や代理店、さらに私や担当役員総出で、市場在庫からの調達にも注力しました。テスト部門に所属する技術者は、業務の約3分の1が代替品の検討に費やされたと思います。代替品はそのまま付け替えることはできません。なかには基板を新たに設計しなければならないケースも出てきます。加えて、市場在庫は通常の仕入品と比べて高価なため、利益率も悪化します。それでも、何より当社が優先したのが、お客様への納品です。しかし、そうまでしても一部、納期遅延でご迷惑をおかけしたケースもありました。さらに部品調達難に起因する納期要因によって、数億円レベルの失注も発生しました。

Q 中期経営計画の進捗はいかがですか？

A 部品調達難による足踏みはあるものの、当期は計画線での着地となりました。開発面についても、部品不足に起因した若干の遅延は見られましたが、テスト、ハンドラどちらも順調に進んでいます。

また、成長投資枠として3年間で40億円を設定していますが、DX（デジタルトランスフォーメーション）投資として5億円余りを決議しました。老朽化した現状のシステムを一掃して、工場を含めた全社的なシステム再構築を進めています。

人財については、人手不足の折、計画当初はかなり苦戦すると考えていましたが、これまでのところ順調に採用できています。

Q SDGsの取り組みについてお聞かせください。

A 事業活動を通じた省エネ化や脱炭素化への取り組みに加えて、当期の新たな取り組みとして、プロバスケットボールの立川ダイス（東京都立川市）、サッカーJリーグの松本山雅FC（長野県松本市）とのスポンサー契約を締結しました。地域貢献が主な目的ですが、当社の知名度向上にも貢献すると考えています。当社のビジネスモデルはB to Bであるため、会社名にしても事業内容にしても、一般にはあまり浸透していません。地域貢献を通じて知名度とイメージのアップが図られると期待しています。

Q 今期(2024年3月期)の展望、重点的な取り組みなどについてお聞かせください。

A 全体的に停滞している半導体市場ですが、当社は比較的堅調な電気自動車関連のお客様も多いことが、好調を維持できている大きな要因だと思っています。今期、後半には市場は回復してくるだろうと見られていますが、当社としては、引き続き中期経営計画に則って、開発、販売戦略を進めるとともに、生産や社内の体制整備に努めていきます。

また、前期、当期と続いた部品不足は、今期も継続しています。調達難は今期も引き続き重点課題であり、通常業務と並行して、その対応には鋭意取り組んでいきます。

その上で今期の業績は、期首の受注残が約60億円と、高い水準にあることも踏まえ、売上高92億円（当期比5.2%増）を見込んでいます。しかし、コスト増や円高による為替差益の剥落、税負担の増加などから、減益を予想しています。

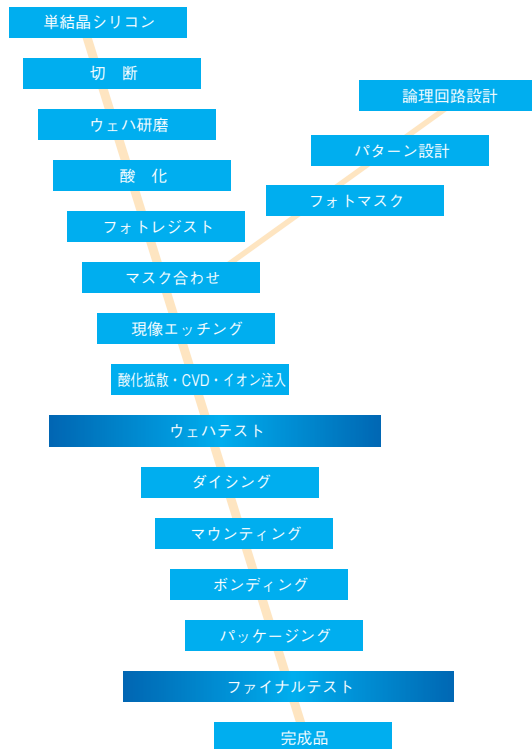
Q 最後に、株主様へのメッセージをお願いいたします。

A 当期、良い結果を得ることができたのは、株主の皆様のご支援があつてこそだと思っています。また、株主様も上場時から約5倍に増えており、それだけ当社への関心も高まっていると認識しています。

中期経営計画では総還元性向35%を目安とした株主還元を掲げており、当期の期末配当は、前期の80円から20円上乘せして、1株当たり100円とさせていただきました。これにより、自社株買いを含む総還元性向は35%水準となりました。

今期は世界経済の先行きも不透明感が増していますが、市場のニーズに応じてターゲットを絞り、経営資源を集中してまいります。株主の皆様におかれましては、引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

半導体検査装置の、 リーディングカンパニーとして、グローバルに、 そして独創的にカスタマーニーズにお応えしています。



製造された各種半導体の品質による分類・選別処理を自動的に行うハンドラ、ハンドラと連動して半導体の電気特性を高速・高精度で測定し、分類・選別の基準となるデータを提供するテスト。これら半導体検査装置は半導体の最終検査（ファイナルテスト）を担い、その精度は半導体、さらには電子機器などの最終製品の品質を決定するといっても過言ではありません。

また、近年は当社の強みである高電圧・大電流なパワー半導体（※）測定技術を継承しつつ、長年蓄積してきた測定技術を活用し、ウェハテスト工程に対応した新しいタイプのテストにも注力しております。複数チップを同時測定処理することにより、従来テストに比べ大幅に生産性向上を図ることができます。

テセックは、ハンドラとテストの専門メーカーとして、また、それらを組合わせたテストシステムのトータルサプライヤーとして、長年のノウハウと確かな技術力を駆使して、高品質・高信頼を追求してきました。

さらに今、トータルシステムや特化したカスタマーニーズへの対応など、検査装置の領域を超えたソリューションの提供にも積極的に挑戦しています。

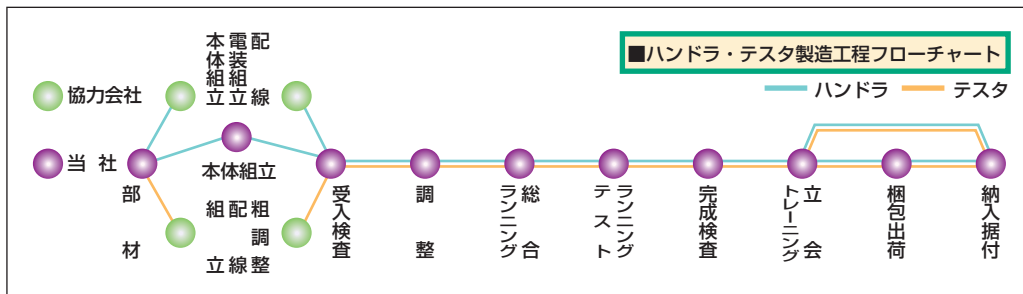
パワー半導体とは = 電力制御や供給機能がある半導体

例えば自動車では、
従来の内燃機関はガソリンなど燃料を使用 ⇒ 排気ガスを排出
パワー半導体は燃料を使わず、電気を使用
電気（電圧や電流）により動力を発生し制御 ⇒ 排気ガスゼロ



パワー半導体による地球温暖化抑制とCO₂削減が可能

このパワー半導体の信頼性試験に当社製品が貢献！



半導体業界は刻々と変わりゆく技術やデバイスの多様化によって、当社が手がける検査装置に求められるレベルも高度になりつつあります。このような時代の流れに対応するために、これまでも独自技術のオリジナリティを磨き、他社との差別化を図ってきました。すでに定評のあるハンドラとテスタはもちろん、MEMSハンドラや一貫システムまで、最先端の市場を見据えた幅広いラインナップでカスタマーニーズにお応えしています。

ハンドラ

ハンドラとは、接続されたテスタからの測定データを受け、設定されたレベルに応じて各種半導体デバイスを自動的に分類・選別する装置です。

チェンジキットによりデバイスの形状、サイズ、重さなどの変化にも柔軟に対応でき、同時にコンパクト設計、シンプル機構、優れた操作性、低価格を実現しています。

対象半導体の種類、用途によっては温度試験対応などの機能が付加され、さらに半導体製造の後工程となるリード切断やマーキングを同時に行う一貫システムも充実しています。

テスタ

テスタとは、各種半導体デバイスの電気特性を高速・高精度に測定するテストシステムです。パソコンの搭載で、ウィンドウズの画面上で対話型式によるテストプログラムを簡単に作成でき、ネットワークにも接続できます。

特に大電流、高電圧に対応するテストシステムでは高度な計測技術により他社の追随を許さない性能を誇り、長年にわたって高シェアを維持しています。また、ロジックICを対象としたDC測定、時間測定、ファンクション測定などの分野もカバーしています。



MEMSテストハンドラ



パワーデバイス用パラレルテストシステム

半導体製造工場が稼働する世界全地域をカバー。 このネットワークが、信頼をより強固に。

リアルタイムの情報を世界各地から収集・分析し、製品や提案として発信するテセックのビジネスモデル。設立当時に、半導体先進国だったアメリカ系企業から技術力を認められ、いち早くグローバルに展開できたことが、独自性を際立たせるきっかけとなりました。以来今日まで拓かれた販売・サービス網は、半導体製造工場のある世界全域をカバーし、なかでもアメリカ、マレーシア、中国の現地法人では、現地のお客様に向けてきわめて密接な営業活動・情報収集を実践しています。そこから生まれる新たな製品・ソリューションは、海外代理店も巻き込んでまさにグローバルに波及し、世界各地での半導体ビジネスに貢献しています。



連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度 2022年3月31日現在	当連結会計年度 2023年3月31日現在
(資産の部)		
流動資産	8,033	9,903
現金及び預金	2,489	3,136
受取手形	221	22
売掛金	2,603	1,891
有価証券	122	725
製品	221	296
仕掛品	1,586	2,602
原材料	453	702
未取消費税等	242	380
その他	94	147
貸倒引当金	△ 1	△ 1
固定資産	4,857	4,433
有形固定資産	1,547	1,488
建物及び構築物	2,525	2,505
減価償却累計額	△ 2,212	△ 2,207
建物及び構築物(純額)	312	297
機械装置及び運搬具	113	114
減価償却累計額	△ 100	△ 105
機械装置及び運搬具(純額)	13	9
工具、器具及び備品	726	709
減価償却累計額	△ 672	△ 662
工具、器具及び備品(純額)	53	47
土地	1,167	1,134
無形固定資産	19	86
ソフトウェア	17	18
ソフトウェア仮勘定	-	66
その他	1	1
投資その他の資産	3,290	2,859
投資有価証券	2,994	2,474
退職給付に係る資産	84	69
繰延税金資産	-	102
保険積立金	198	191
その他	18	25
貸倒引当金	△ 6	△ 4
資産合計	12,890	14,337

科 目	前連結会計年度 2022年3月31日現在	当連結会計年度 2023年3月31日現在
(負債の部)		
流動負債	1,395	1,391
買掛金	315	387
未払金	118	117
未払費用	120	126
契約負債	200	252
未払法人税等	361	179
賞与引当金	168	196
製品保証引当金	38	37
修繕引当金	41	59
その他	31	35
固定負債	195	37
長期未払金	4	1
繰延税金負債	190	27
その他	-	8
負債合計	1,590	1,429
(純資産の部)		
株主資本	10,868	12,465
資本金	2,521	2,521
資本剰余金	3,370	3,376
利益剰余金	5,178	6,982
自己株式	△ 202	△ 414
その他の包括利益累計額	430	441
その他有価証券評価差額金	524	472
為替換算調整勘定	△ 93	△ 31
非支配株主持分	1	1
純資産合計	11,300	12,907
負債純資産合計	12,890	14,337

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2021年4月1日 至：2022年3月31日	自：2022年4月1日 至：2023年3月31日
売 上 高	7,512	8,743
売 上 原 価	4,163	4,652
売 上 総 利 益	3,348	4,090
販売費及び一般管理費合計	1,600	1,957
営 業 利 益	1,748	2,133
営 業 外 収 益 合 計	328	394
営 業 外 費 用 合 計	10	14
経 常 利 益	2,065	2,513
特 別 損 失 合 計	-	56
税金等調整前当期純利益	2,065	2,456
法人税、住民税及び事業税	332	435
法 人 税 等 調 整 額	10	△ 234
当 期 純 利 益	1,722	2,255
非支配株主に帰属する当期純利益	0	0
親会社株主に帰属する当期純利益	1,722	2,255

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

科 目	前連結会計年度	当連結会計年度
	自：2021年4月1日 至：2022年3月31日	自：2022年4月1日 至：2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 117	1,445
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 825	△ 117
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58	△ 676
現金及び現金同等物に係る換算差額	156	163
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△ 845	814
現金及び現金同等物の期首残高	3,079	2,233
現金及び現金同等物の期末残高	2,233	3,048

連結対象子会社

アメリカ	TESEC, INC. /Head Office (カリフォルニア州) /Arizona Office (アリゾナ州)
マレーシア	TESEC (M) SDN.BHD.
中国	泰賽国際貿易 (上海) 有限公司

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本					その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	2,521	3,370	5,178	△ 202	10,868	524	△ 93	430	1	11,300
当 期 変 動 額										
剰 余 金 の 配 当			△ 451		△ 451					△ 451
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			2,255		2,255					2,255
自 己 株 式 の 取 得				△ 229	△ 229					△ 229
自 己 株 式 の 処 分		5		18	23					23
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純額)						△ 51	61	10	0	10
当 期 変 動 額 合 計	-	5	1,803	△ 211	1,596	△ 51	61	10	0	1,607
当 期 末 残 高	2,521	3,376	6,982	△ 414	12,465	472	△ 31	441	1	12,907

会社概要

社名	株式会社テセック TESEC Corporation
所在地	本社（〒207-0023） 東京都東大和市上北台三丁目391番地の1 TEL：042-566-1111(代) FAX：042-562-6161 伊那事業所（〒399-4601） 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346 TEL：0265-79-6611(代) FAX：0265-79-7883 テセック熊本（〒861-2202） 熊本県上益城郡益城町田原1155-12 テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F TEL：096-287-1551 FAX：096-287-1552
設立	1969年12月22日
資本金	25億21百万円
従業員数	209名(連結)、182名(単体) (2023年3月31日現在)
海外現地法人	TESEC, INC. (アメリカ) TESEC (M) SDN. BHD. (マレーシア) 泰賽国際貿易(上海)有限公司(中国)
事業内容	半導体検査装置であるハンドラ（半導体の電氣的測定結果をもとに性能毎に分類・選別する装置）、 テスト（半導体の性能を電氣的に測定する装置） およびパーツ等（予備部品、保守部品等）の開発・ 製造・販売
URL	https://www.tesec.co.jp

役員 (2023年6月29日現在)

代表取締役社長	田中賢治
取締役	尾亦利夫
取締役	宮脇浩幸
取締役	渡邊弘一
取締役(常勤監査等委員)	矢崎七三
取締役(監査等委員)	南 忠良
取締役(監査等委員)	舛川博昭

株式の状況 (2023年3月31日現在)

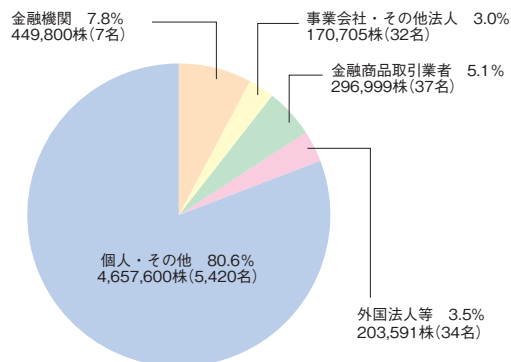
発行可能株式総数	20,000,000株
発行済株式の総数	5,778,695株
株主数	5,530名
大株主(上位10名)	

株主名	持株数	持株比率
田中 綏子	426千株	7.6%
村井 昭	332	5.9
日本生命保険相互会社	186	3.3
勝田 知男	177	3.2
山村 博	166	3.0
株式会社りそな銀行	164	2.9
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	125	2.2
テセック社員持株会	118	2.1
大塚 佳苗	106	1.9
大塚 正樹	103	1.9

(注) 1.当社は、自己株式を195,800株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月
基準日 3月31日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711 (通話料無料)
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
公告方法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由
によって電子公告をすることができな
い場合は、日本経済新聞に掲載いたし
ます。
URL <https://www.tesec.co.jp>
1単元の株式数 100株

株式会社 テセック

本社 〒207-0023 東京都東大和市上北台三丁目391番地の1
TEL 042-566-1111 (代) FAX 042-562-6161
伊那事業所 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪16346
TEL 0265-79-6611 (代) FAX 0265-79-7883
テセック熊本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原1155-12
テクノ・リサーチパーク テクノ・ラボラトリビル2F
TEL 096-287-1551 FAX 096-287-1552

URL <https://www.tesec.co.jp>